

2008年3月期 決算説明会

株式会社ディスコ

2008年5月13日
大和コンファレンスホールA2B

「見通し」に関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動等があります。

本日の説明

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

本日の説明

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

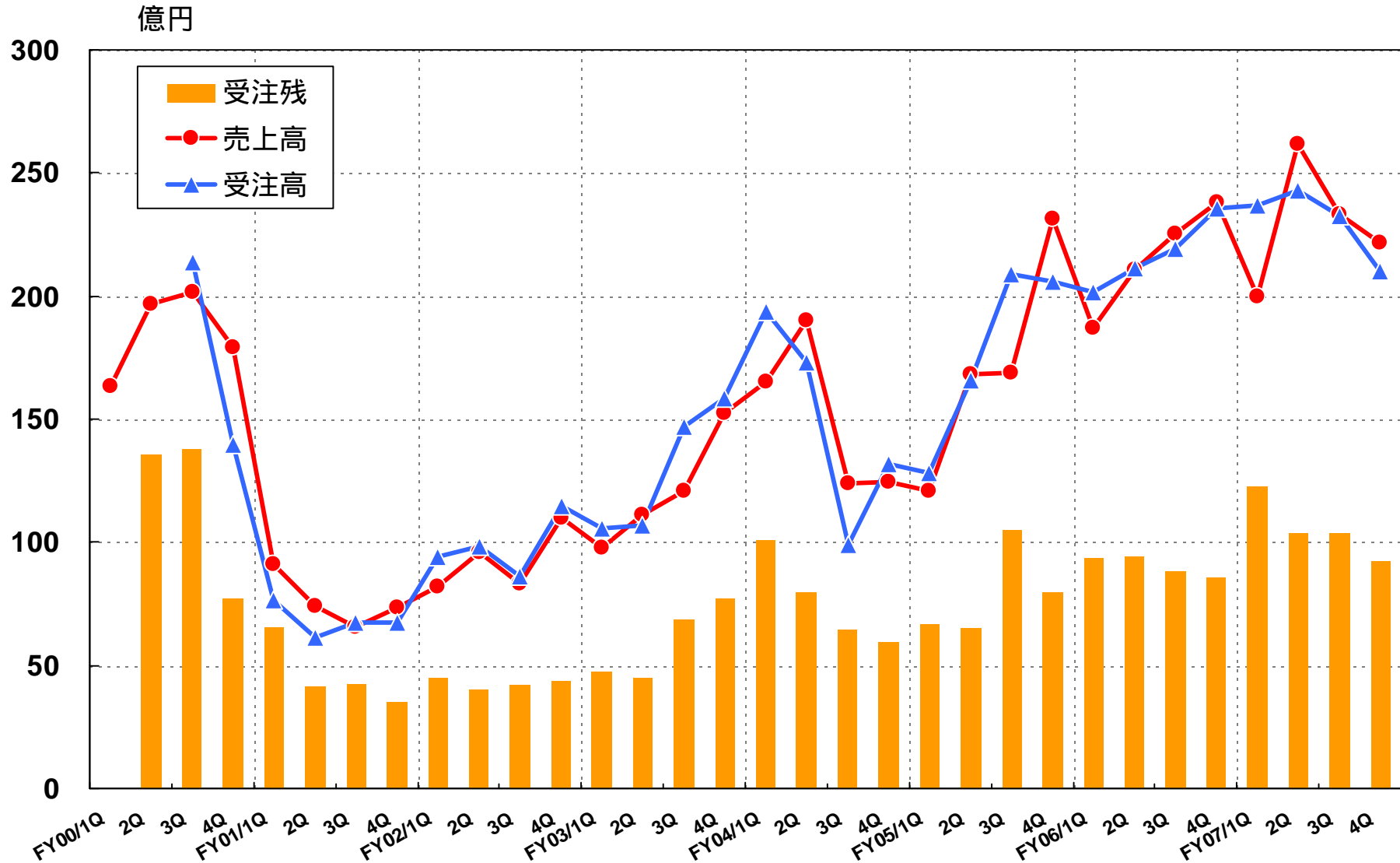
溝呂木 齊

3. 質疑応答

2008年3月期決算概要

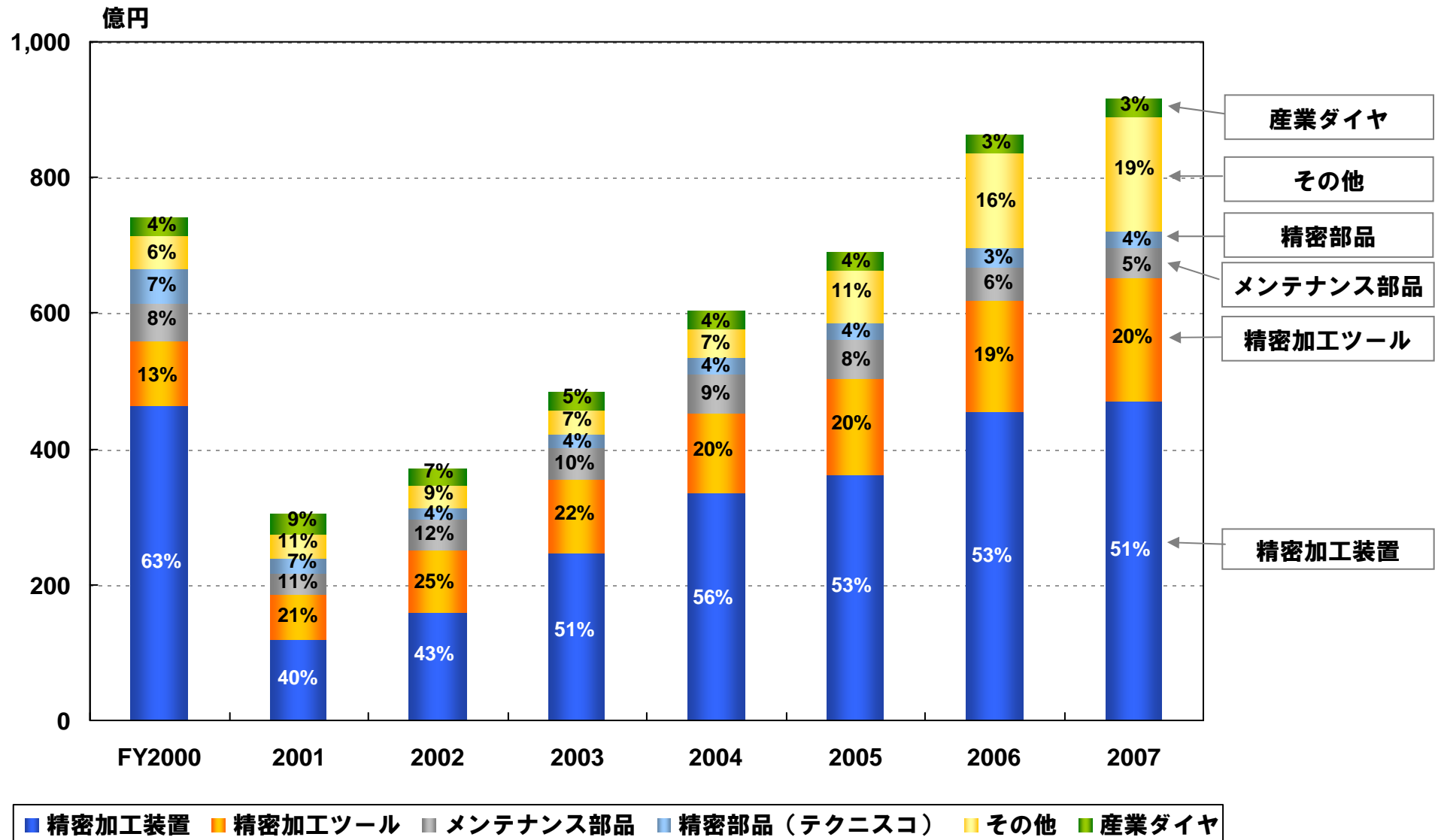
(単位: 億円 四捨五入)	2005年度	2006年度	2007年度	対前年比 (%)	備考
売上高	688	861	916	6.3%	過去最高の売上高を更新
売上総利益	361	440	468	-	
GP率	52.5%	51.1%	51.1%	0pt	前年と同水準を維持
営業利益	139	195	193	-1.0%	販売管理費増により若干減益
経常利益	144	196	185	-5.6%	営業外費用: 為替差損12億円
経常利益率	20.9%	22.8%	20.3%	-2.5pt	
税引き前利益	133	177	184	-	
当期純利益	82	109	111	1.6%	外国税額控除分8億円等
一株あたり利益(円)	251.85	321.22	326.27	-	
受注高	708	868	923		
受注残	79	86	92		

連結売上高・受注高推移

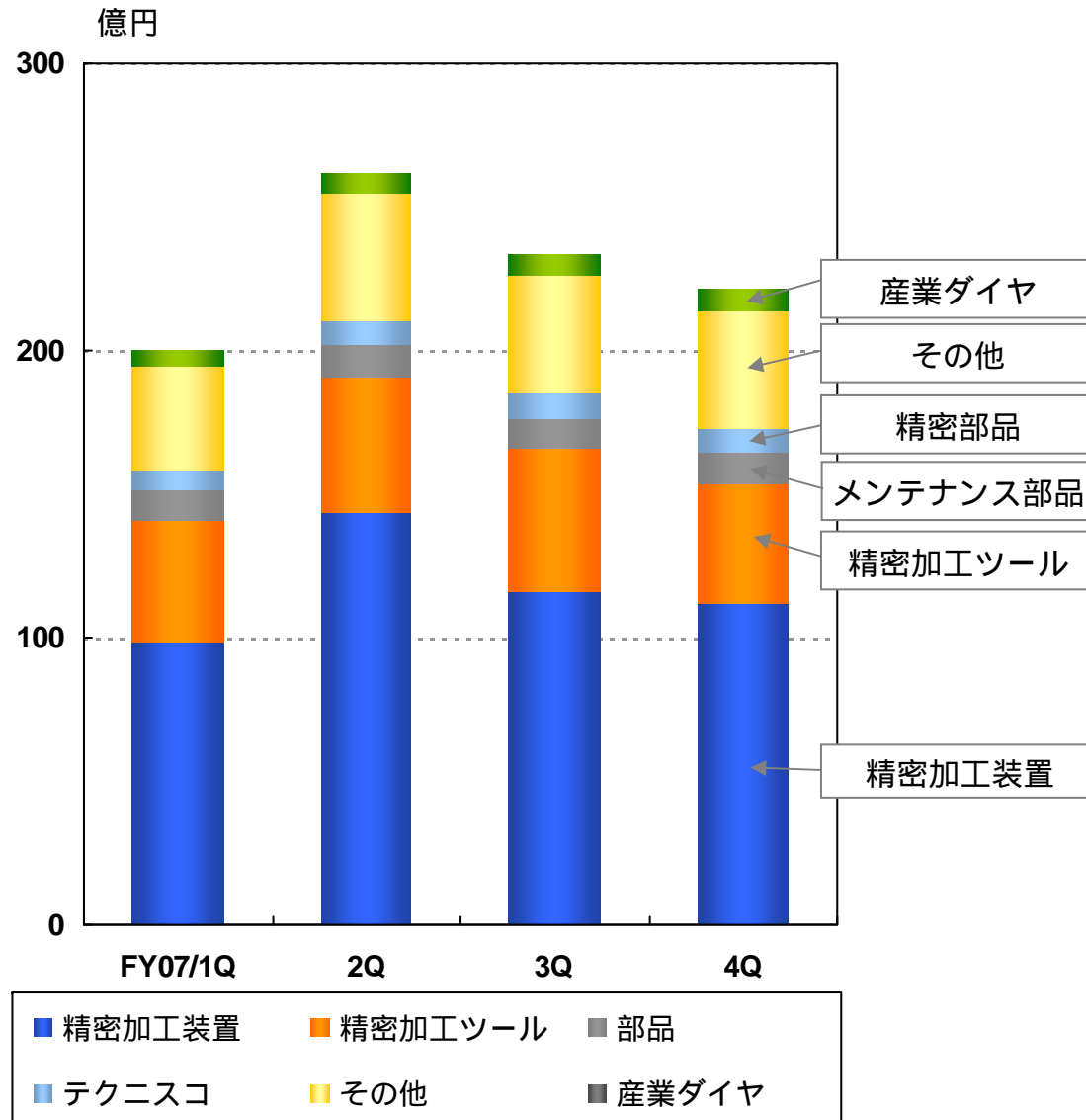


注: 2000年度第3四半期より四半期決算開示

連結売上高 製品群別構成比



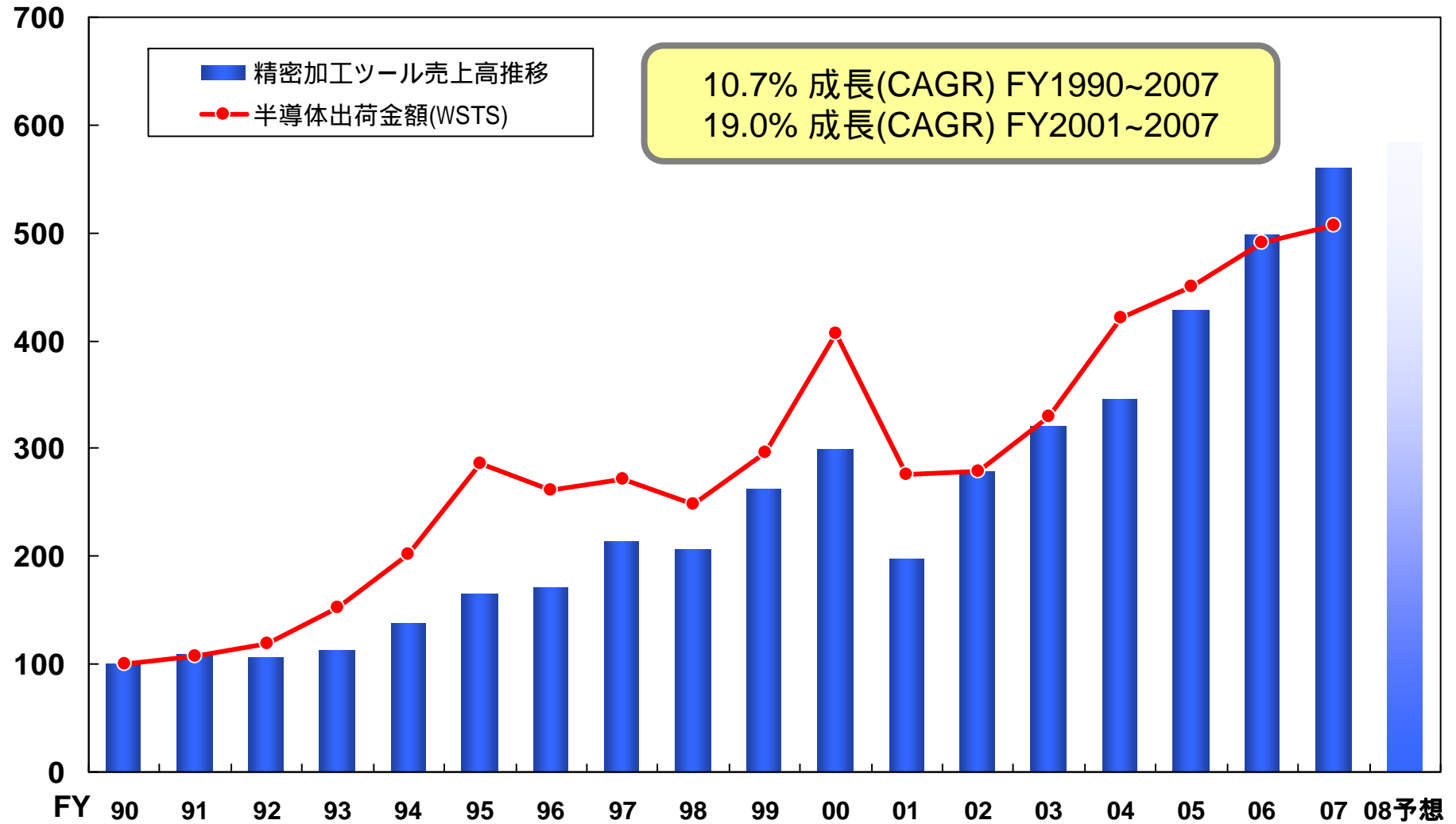
連結売上高 製品群別構成比 四半期推移



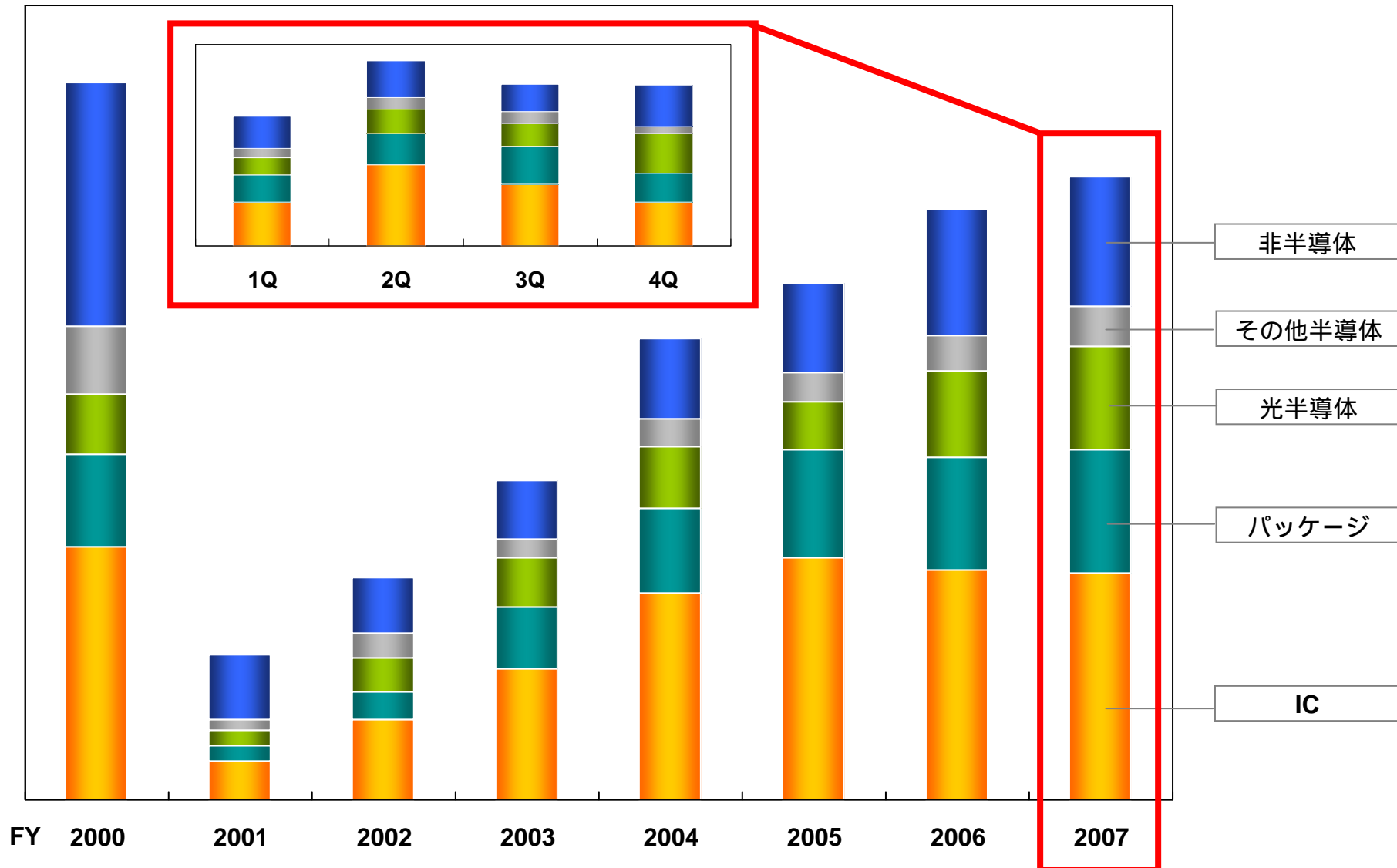
- 1Qにメモリ市況の悪化から低迷した台湾、韓国が2Qに入って復調
- 上期実績では過去最高の前下期とほぼ同水準の売上を達成
- 精密加工ツールは、生産数量の増加局面が続き2Q,3Qと過去最高を更新
- 3Q後半以降、サブコンを中心に投資抑制の動きがありやや減速
- しかし、精密加工装置、精密加工ツールともに通期では過去最高の売上を達成

精密加工ツール売上高推移 (単体)

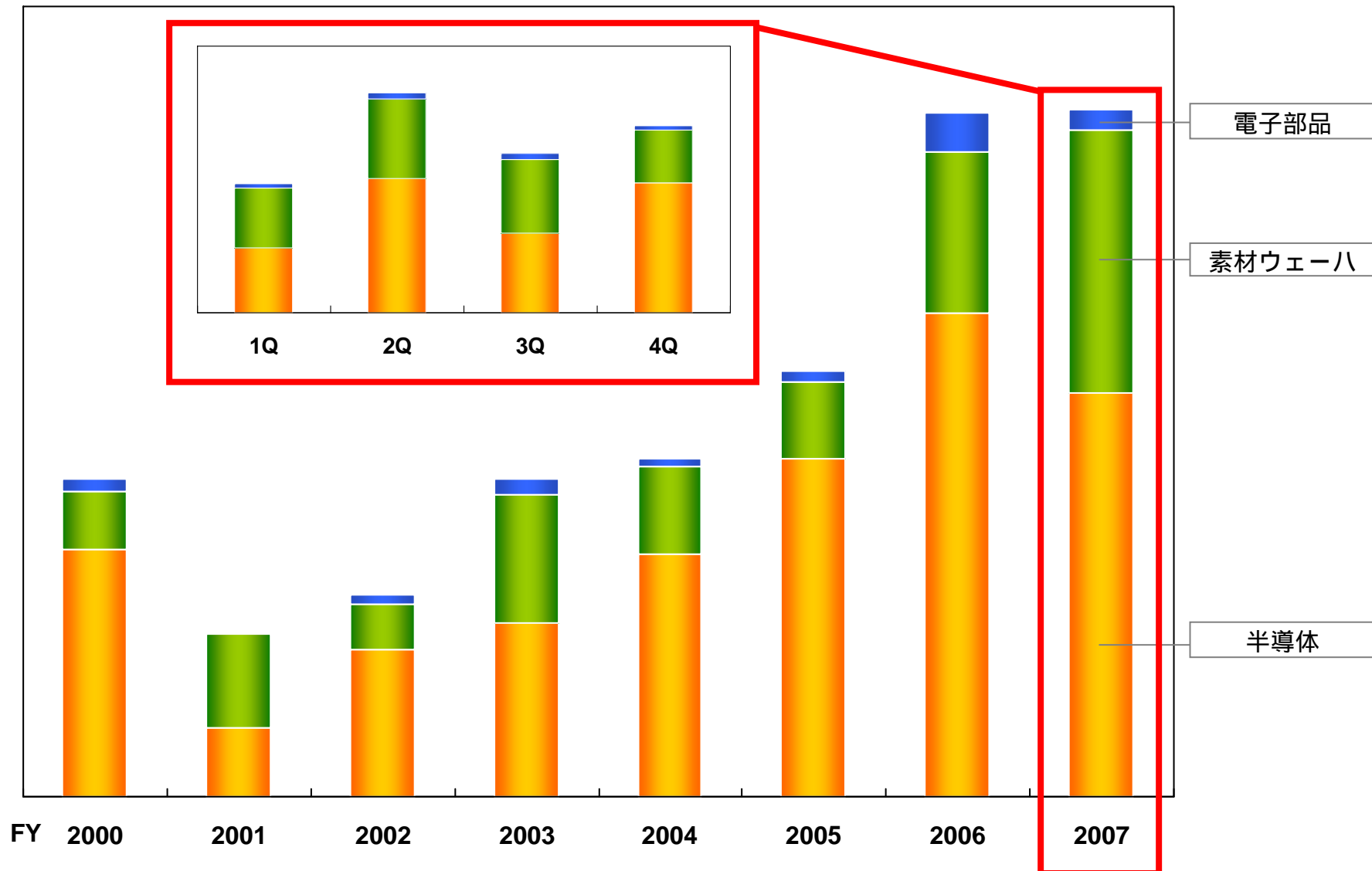
指数 FY1990 = 100



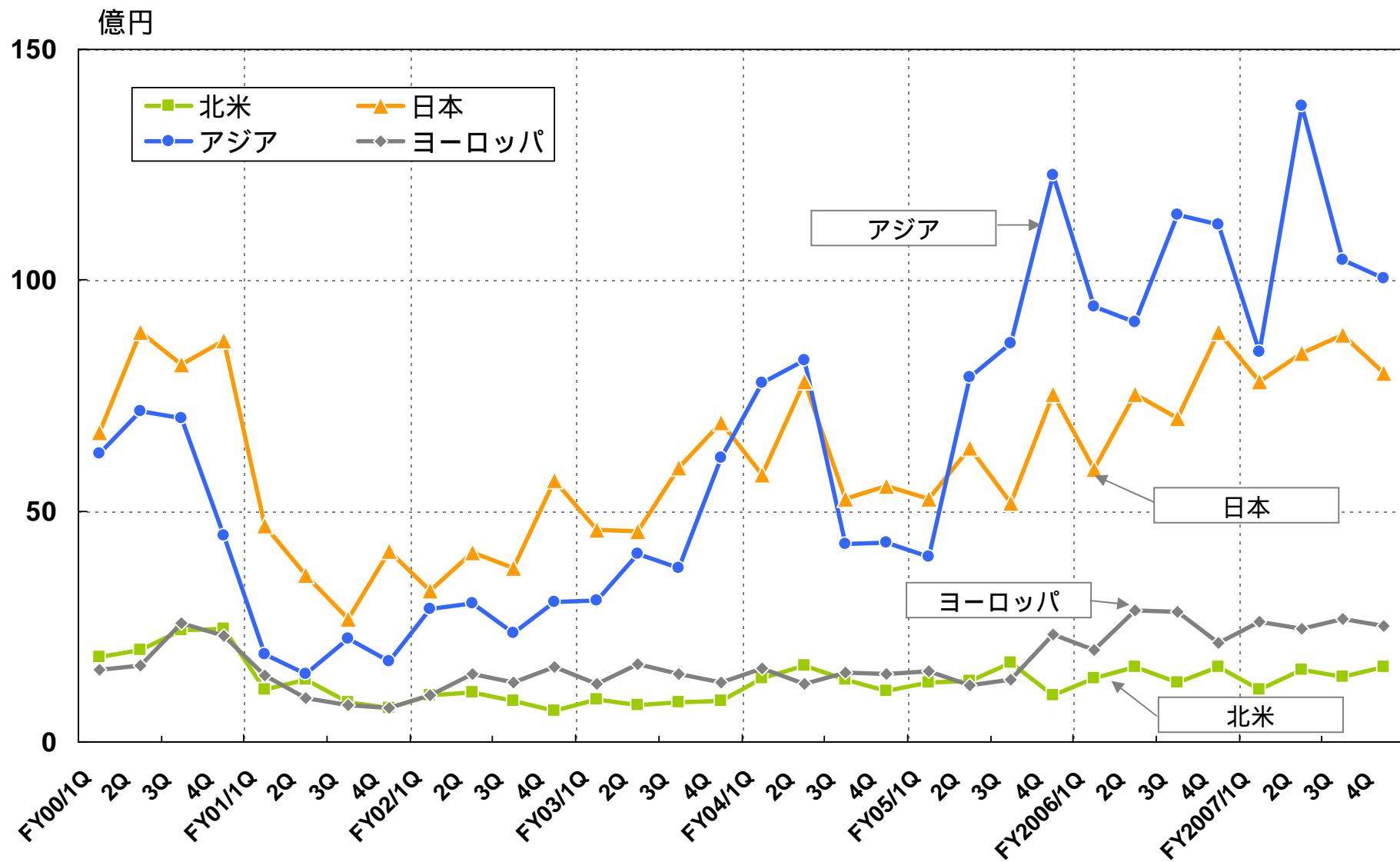
ダイサ売上構成 (アプリケーション別・単体)



グラインダ売上構成 (アプリケーション別・単体)



地域別売上高推移



バランスシート(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)

	2006年度	2007年度	増減
	通期末 (07年3月31日)	通期末 (08年3月31日)	対前年比
流動資産	758	699	-59
現預金	270	191	-79
受取手形・売掛金	278	271	-7
棚卸資産	173	199	26
その他	38	38	-
固定資産	380	487	107
有形・無形固定資産	345	421	76
投資その他の資産	35	66	31
資産合計	1,138	1,186	48
流動負債	288	263	-25
固定負債等	31	26	-5
株主資本等	819	897	48
自己資本比率 (%)	71.5%	75.0%	3.5pt
負債純資産合計	1,138	1,186	48

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)		2006年度 通期	2007年度 通期	2007年度中間期 (ご参考)
営業キャッシュフロー		132	93	33
	税前純利益	177	185	110
	減価償却費	30	37	15
	売上債権・棚卸資産・仕入れ債務	-29	-35	-31
	法人税等の支払額	-65	-89	-50
	その他	19	-5	-12
投資キャッシュフロー		-90	-118	-61
	有形固定資産の取得による支出	-49	-94	-31
	定期性預金の預入による支出・収入他	-41	-24	-30
財務キャッシュフロー		-24	-32	-19
	有利子負債の減少	-3	-2	-3
	親会社による配当金の支払額	-22	-27	-15
	その他	1	-3	-1
フリーキャッシュフロー		42	-25	-28
現金および現金同等物の増加額		20	-60	-46
現金および現金同等物の期末残高		241	181	195

2009年3月期業績予想

(単位: 億円 四捨五入)

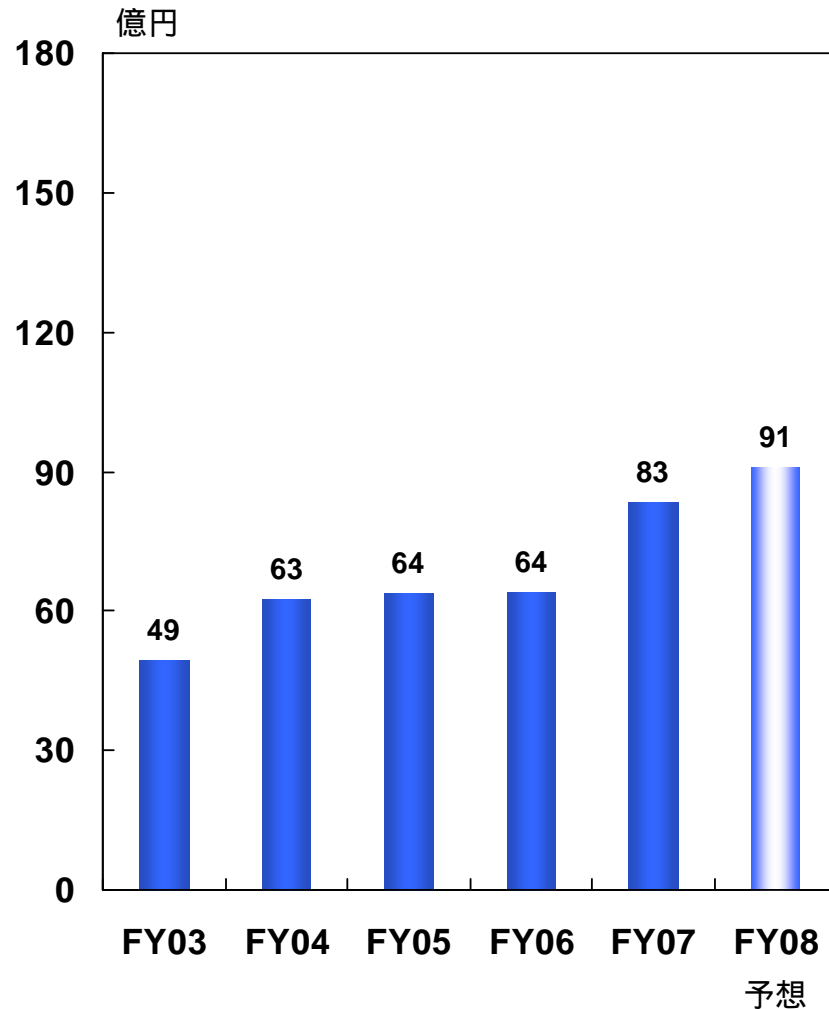
	上期予想	下期予想	通期予想 (5月12日)	【ご参考】 2007年度 通期	対前年比
売上高	453	437	890	916	-2.9%
営業利益	83	80	163	193	-15.7%
営業利益率	18.3%	18.3%	18.3%	21.1%	-2.8pt
経常利益	84	86	170	186	-8.4%
経常利益率	18.5%	19.7%	19.1%	20.3%	-1.2pt
当期純利益	47	53	100	111	-10.0%
純利益率	10.4%	12.1%	11.2%	12.1%	0.9pt

減価償却費、先行開発投資の継続によるR&D費用等の増加により合計20億円弱の利益減少要因

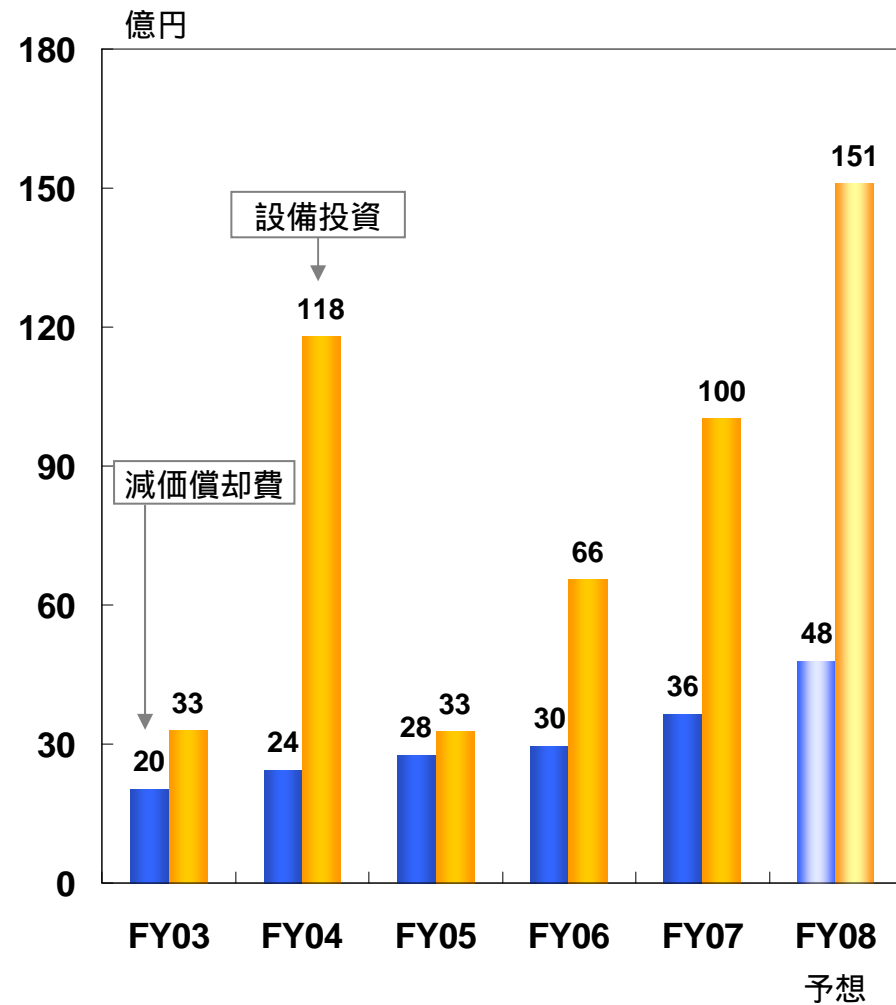
特別損失 低価法対処、建物の除却損等で7.8億円を見込む
 為替前提 US\$:100円 EUR:150円 SGP\$:70円

連結 研究開発費/設備投資見通し

研究開発費



減価償却費・設備投資



本日の説明

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

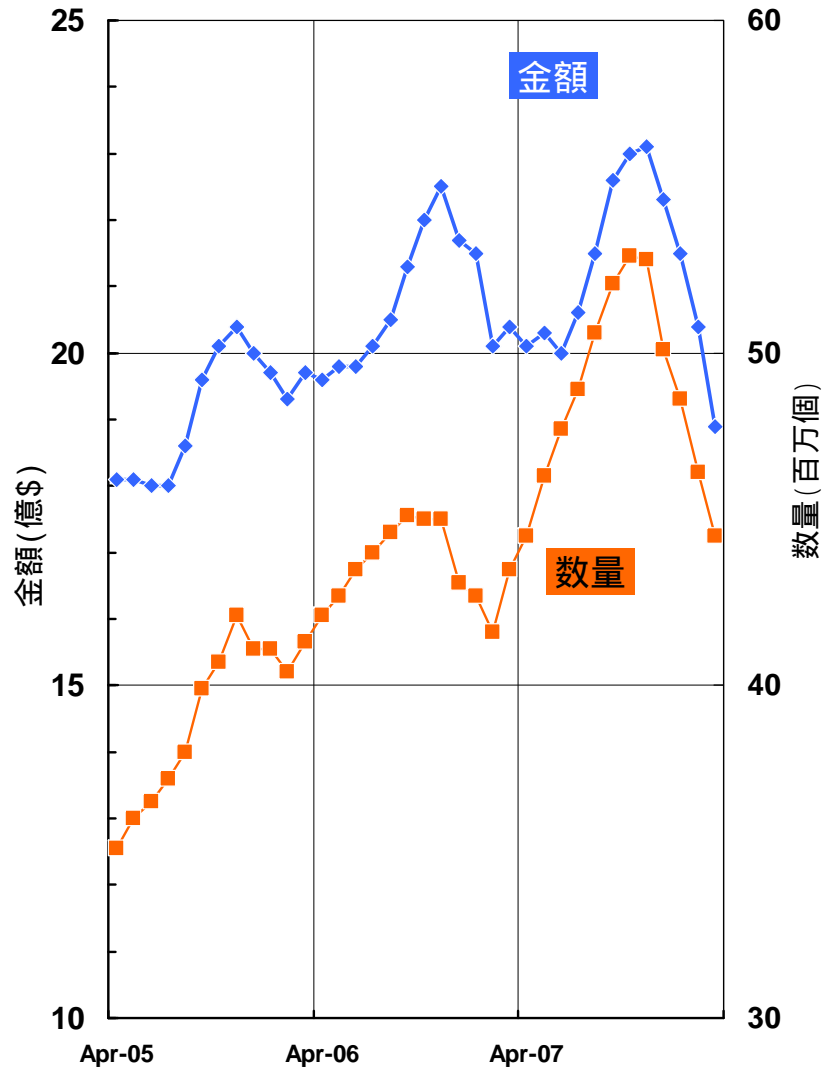
溝呂木 斉

3. 質疑応答

事業環境

事業環境

半導体出荷推移(WSTS)



市場環境

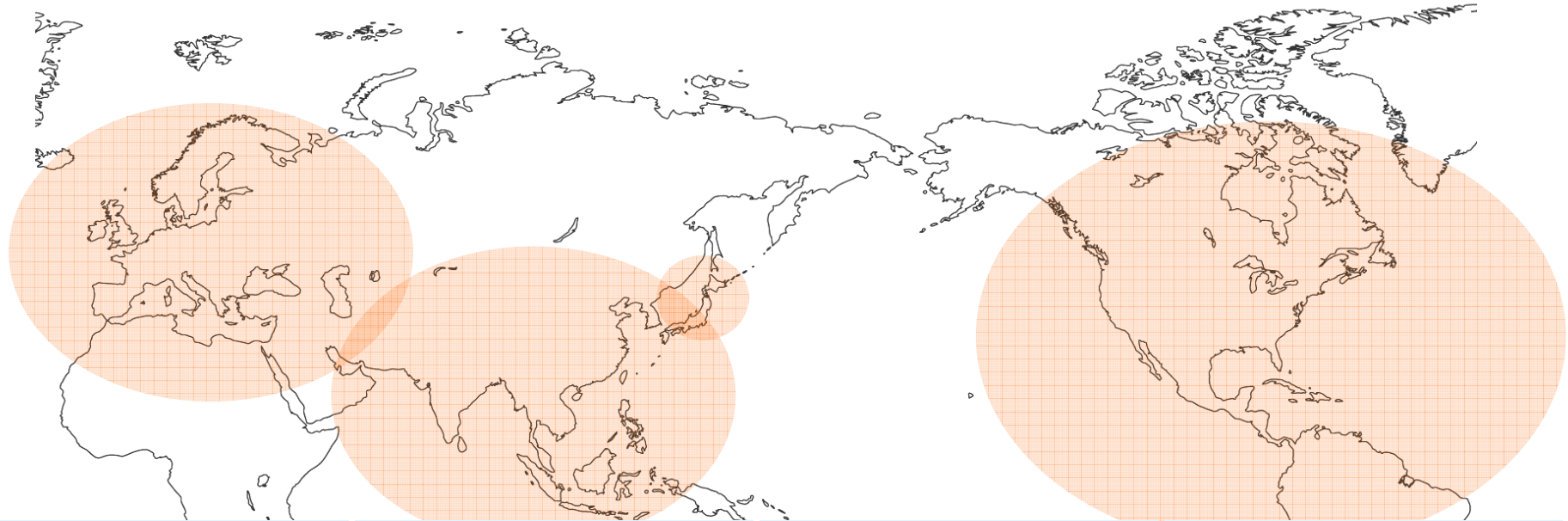
- 半導体業界全体は低調
 - 市場の動きを窺っている分野/メモリ
 - 積極的に投資する分野/LED
- 08年度半導体製造装置の投資動向
 - 調整期間は長期化しない
 - 組立装置の落ち込みは装置市場全体と比べると小さい
- 数量ベースでの半導体・電子部品生産はプラス成長を堅持

事業機会

- 米国Fabless企業を中心に台湾への発注は活発化しつつある
- 新規成長市場としてLED切断用レーザの引き合いが活発化
- 薄化は今後もさらに高い技術力や生産性向上を求められる

地域別 事業の動向

各地域のニーズに柔軟に対応し、顧客価値の最大化を図る

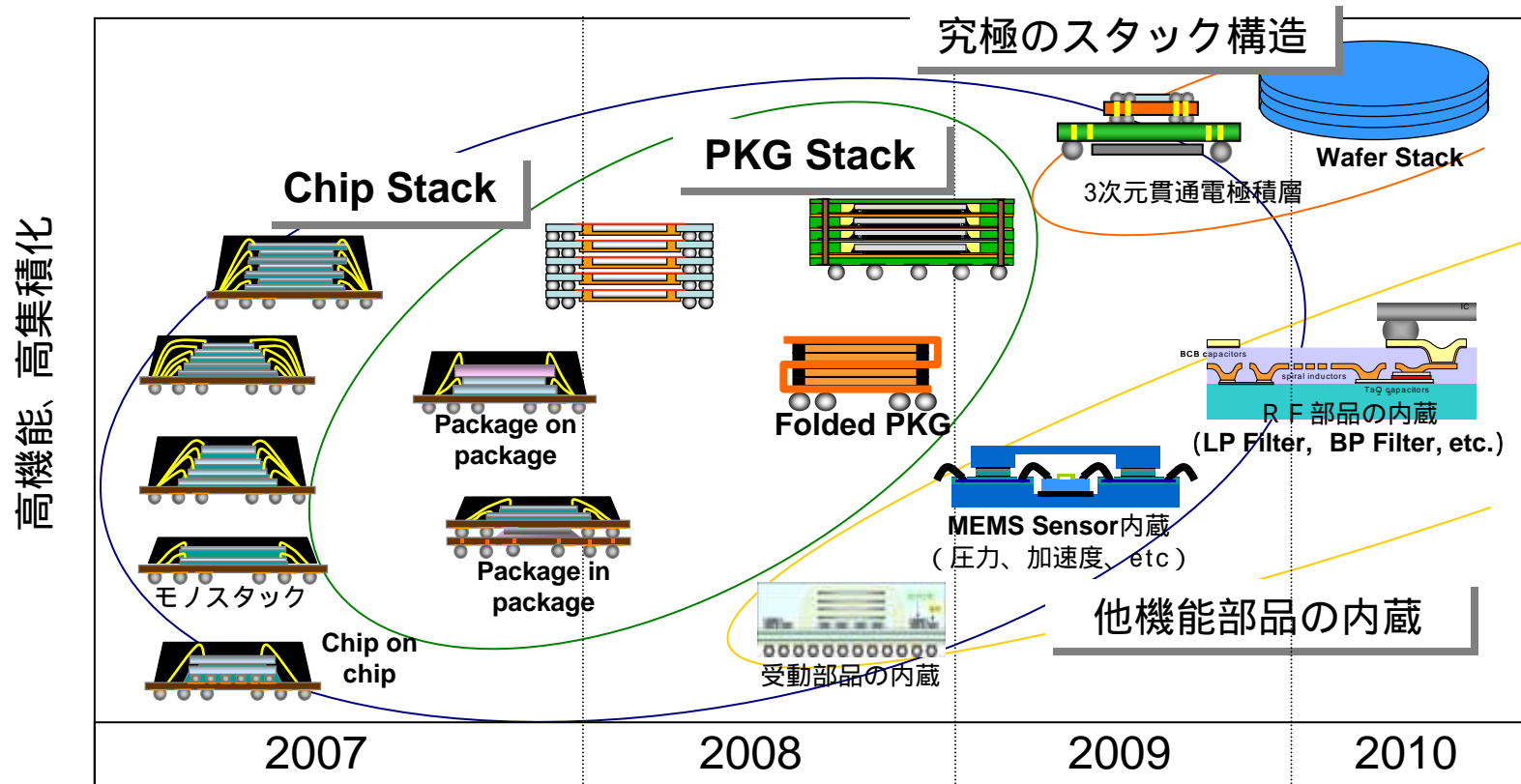


欧州	アジア	日本	北米地域
<ul style="list-style-type: none">• ディスコ独自の先端技術開発を先導• TAIKO(車載半導体) DBGなどで実績あり	<ul style="list-style-type: none">• アプリケーション対応の拠点を設置(台湾・中国)• 中国事業の伸びが高い	<ul style="list-style-type: none">• 戦略投資への対応力強化• 最先端の薄化技術• レーザアプリケーションも多様化	<ul style="list-style-type: none">• 大手IDMの開発期間の短縮化• 量産への対応力の強化

最新技術動向

最新薄化トレンド

SiPから実装の更なる高密度化
積層化に向けたThrough Silicon Via (TSV)技術へ



量産ベースチップ厚予測	2007	2008	2009	2010
	75 - 50um	50 - 30um	30 - 25um	25um -
JJTR ロードマップ For extreme thin package	40um	35um	35um	25um -
ITRS 予測 For extreme thin package	20um	20um	15um	15um -

戦略分野の動向：薄化(1/2)



最新 薄化インラインシステム DGP8761-DFM2800

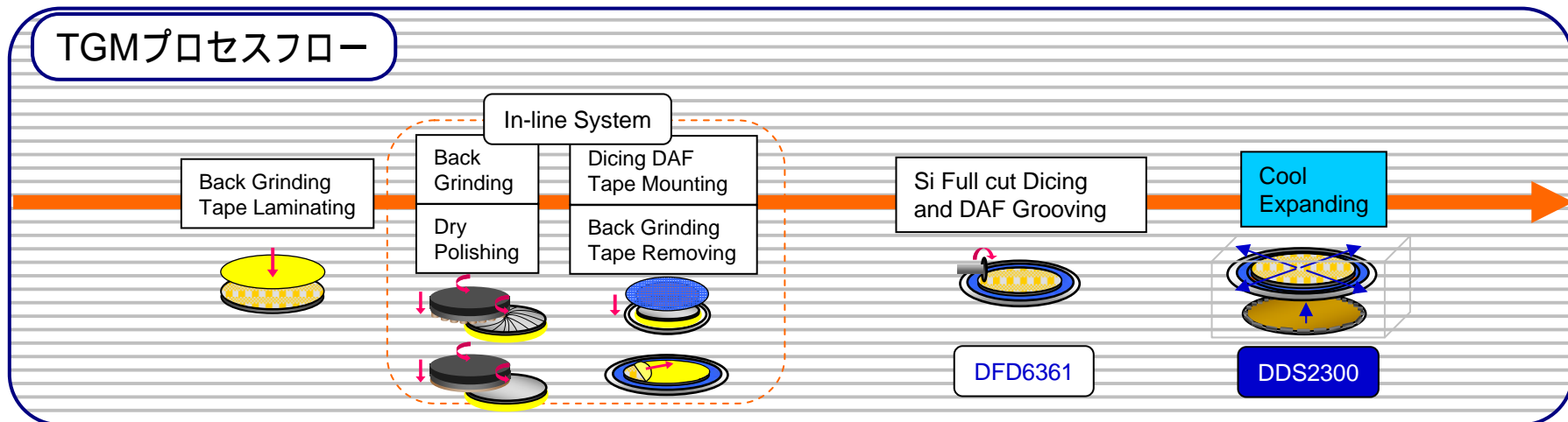


DGP8761 加工点 (手前左側が3軸目(ストレスリリーフ))

- メモリーメーカーの採算悪化により、**07**年末より投資を先送り
- 一方で第4四半期にロジック向けの出荷が堅調
- **08**年度は、更なる高度な薄化技術開発案件に取り組む

戦略分野の動向：薄化(2/2)

- アプリケーション開発を進化させ、高度化する技術ニーズへ対応
 - 08年度はDGP8761-DFM2800インラインシステムの評価・引き合いを継続して実施
 - TGM (Thin Grinding Mounting) プロセスフローを確立
- DDS2300を使用することで、DAF付きチップのピックアップ性が大幅に向上



戦略分野の動向：レーザ(1/2)



DFL7260

- **Low-k用途のほか、LED向け
サファイアウェーハ用途も拡大中**

→07年度よりLED向け装置の出荷が増大
(08年度も継続する見込み)

照明・車載・TV/PCバックライト等の需要増へ対応

→国内大手LEDメーカーのDFL導入により
他メーカーに波及する可能性あり

- **大手IDMだけでなく、サブコン向けの出荷も堅調**

戦略分野の動向：レーザー(2/2)

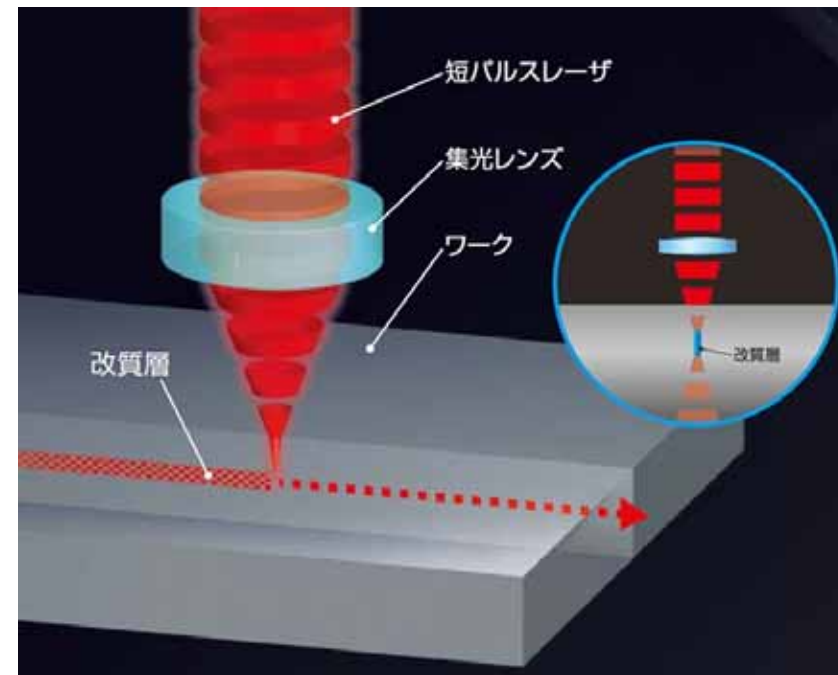
- セミコンジャパン2007にて発表したステルスダイシングを行うDFL7340・DFL7360の評価引き合いが多数
 - ➔特に、加工負荷・加工屑を嫌うMEMSデバイスメーカーなど



DFL7360(300mm)



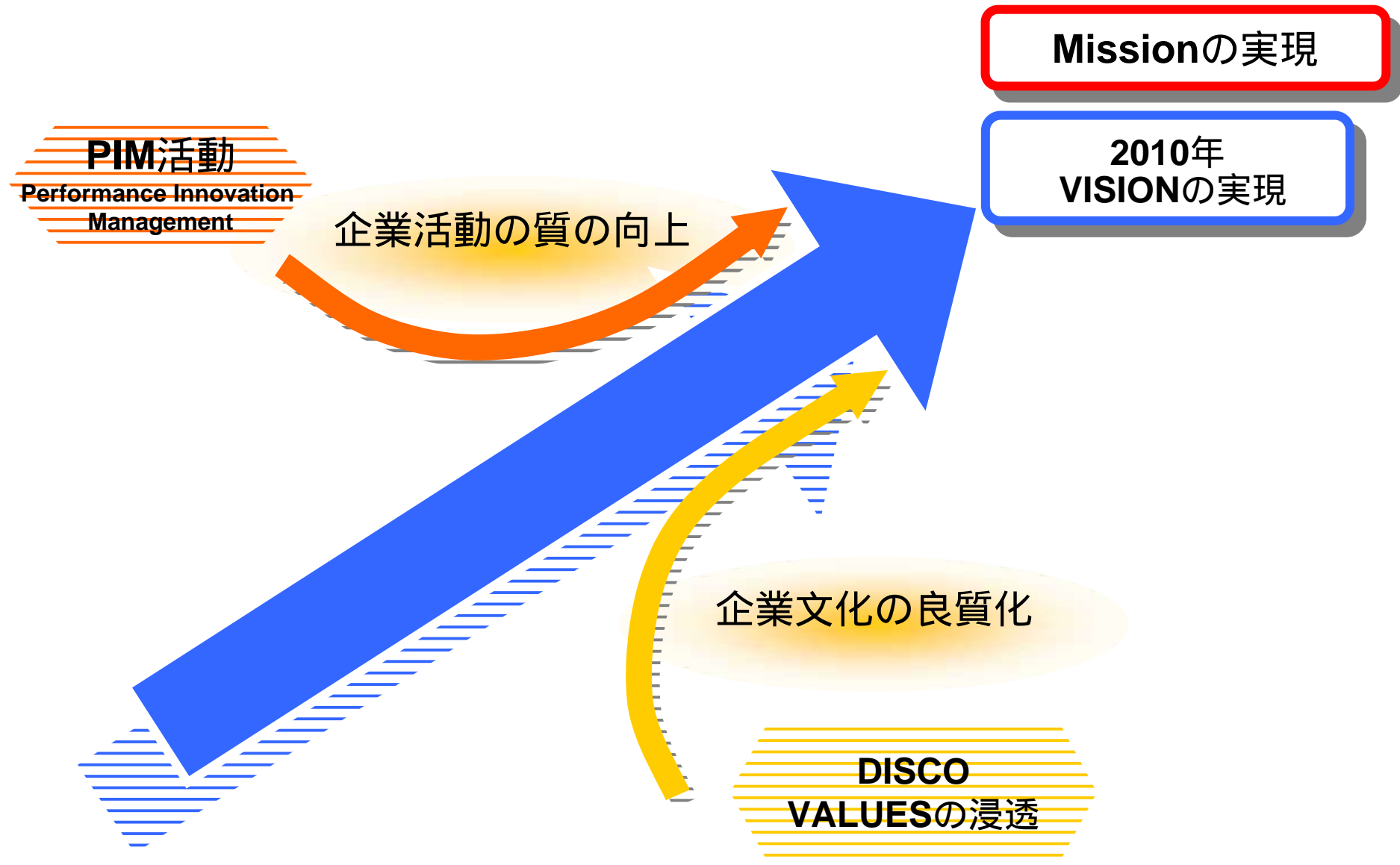
DFL7340(8Inch)



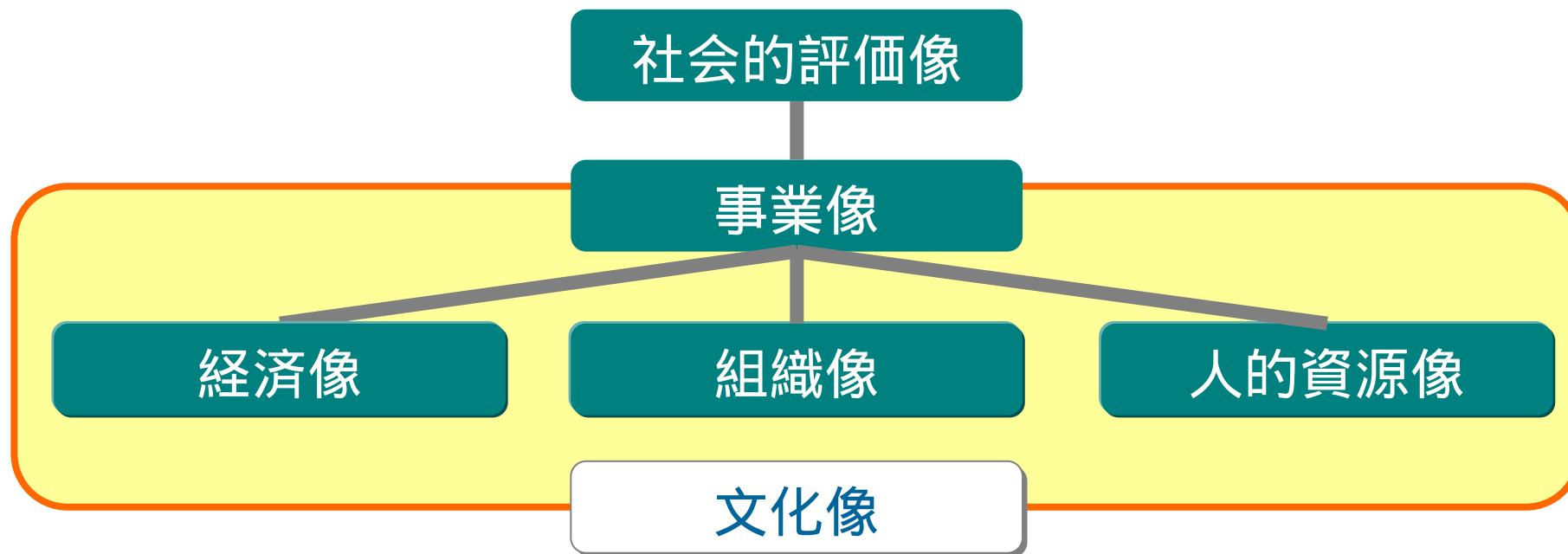
ステルスダイシング技術

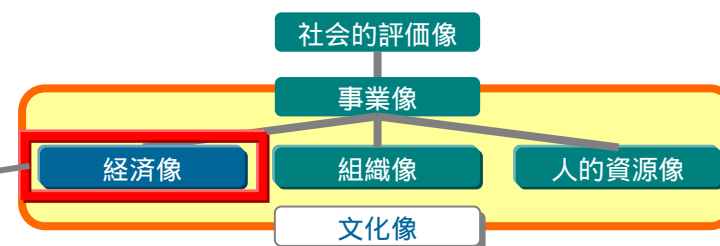
経営方針

ディスコの経営構造



2010年における ディスコのあるべき姿を6つの側面から定義

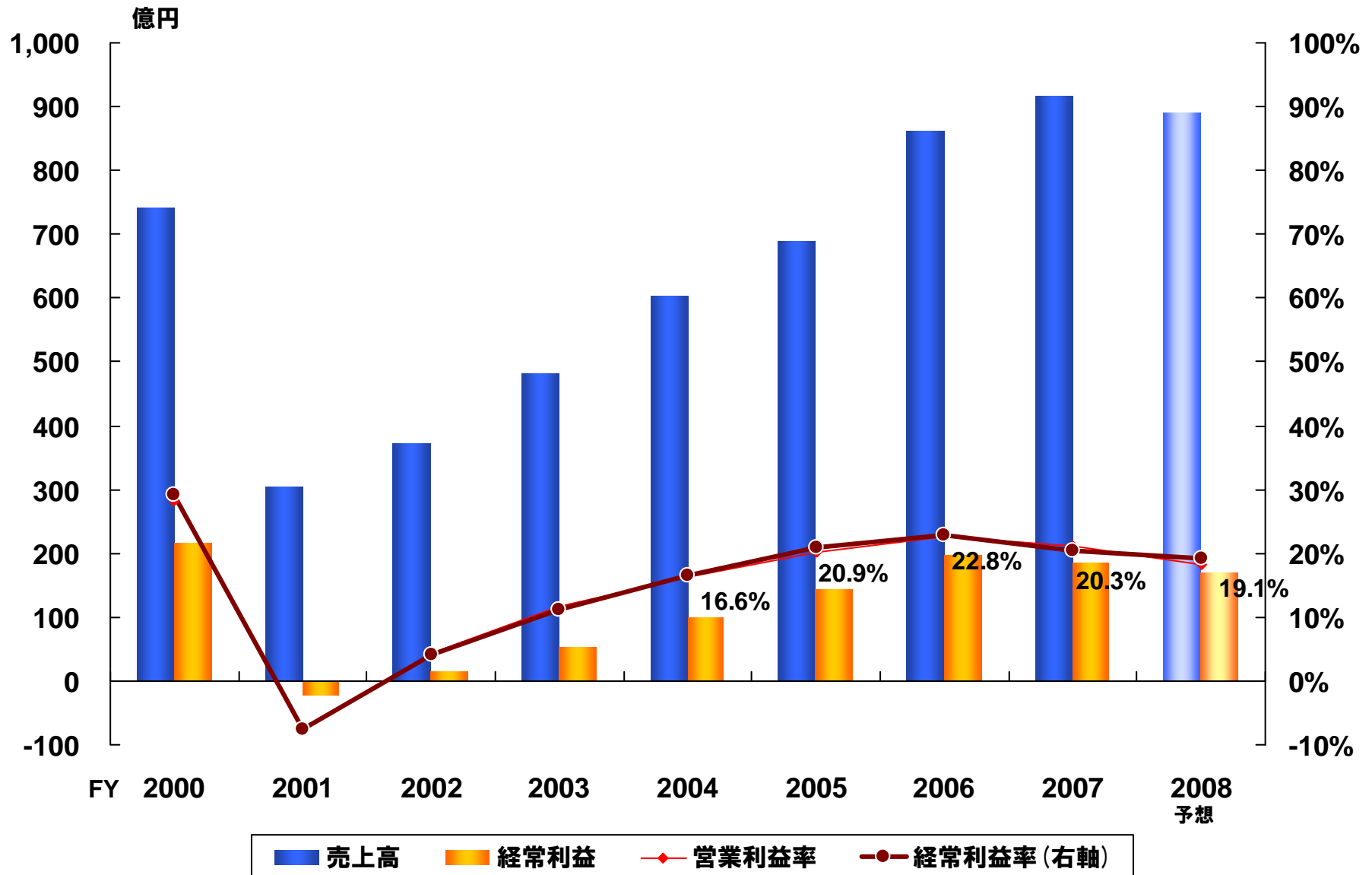




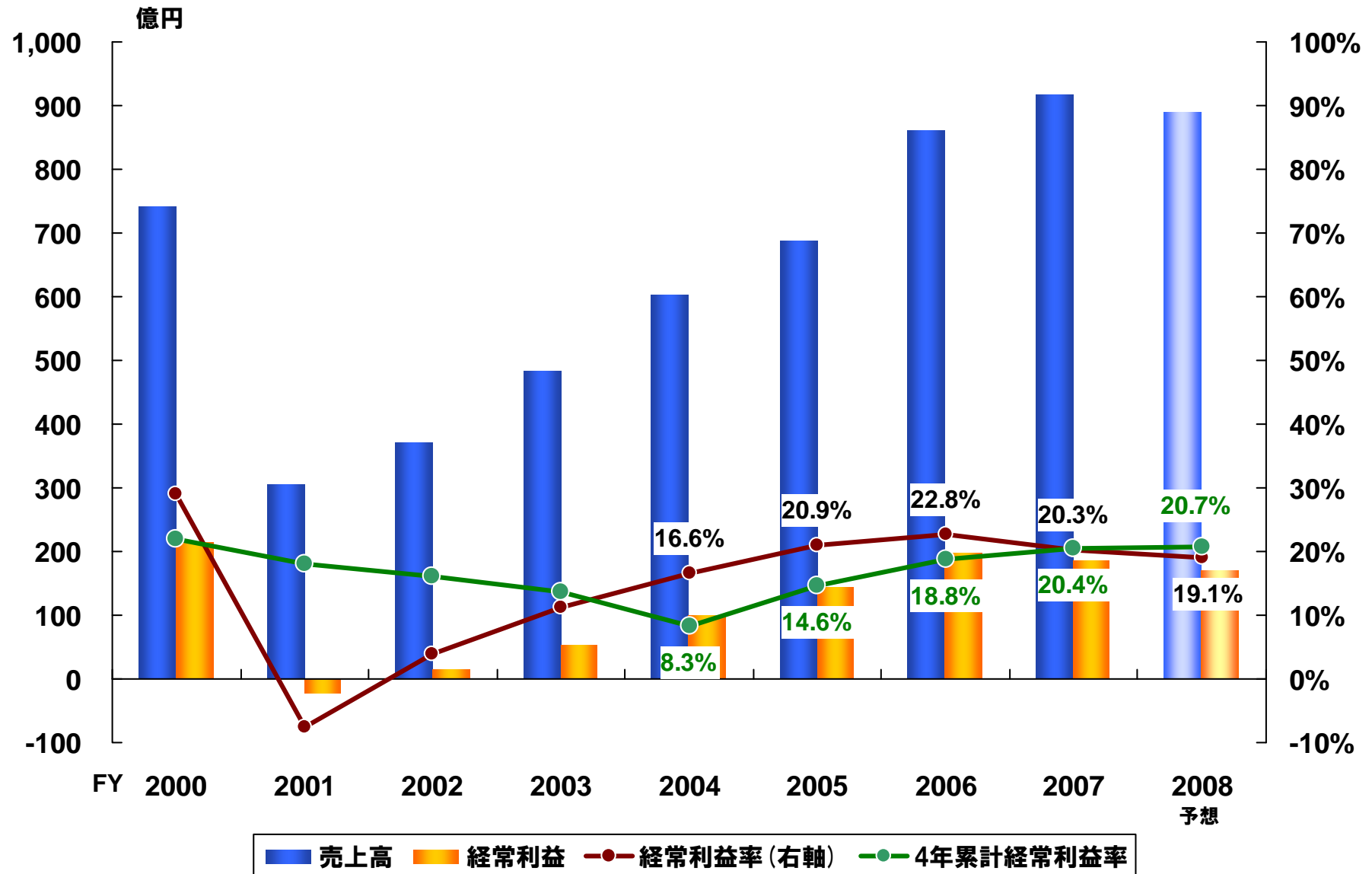
- 企業の成長を支える十分な経済的「能力と構造」を持っている

– 4年累計で、**20%以上の売上高経常利益率**を維持する態勢が出来ている

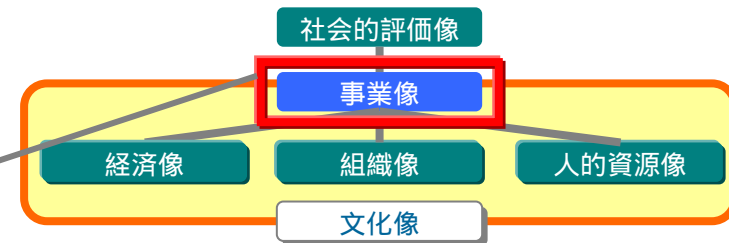
連結業績推移



連結業績推移



DISCO VISION 事業像

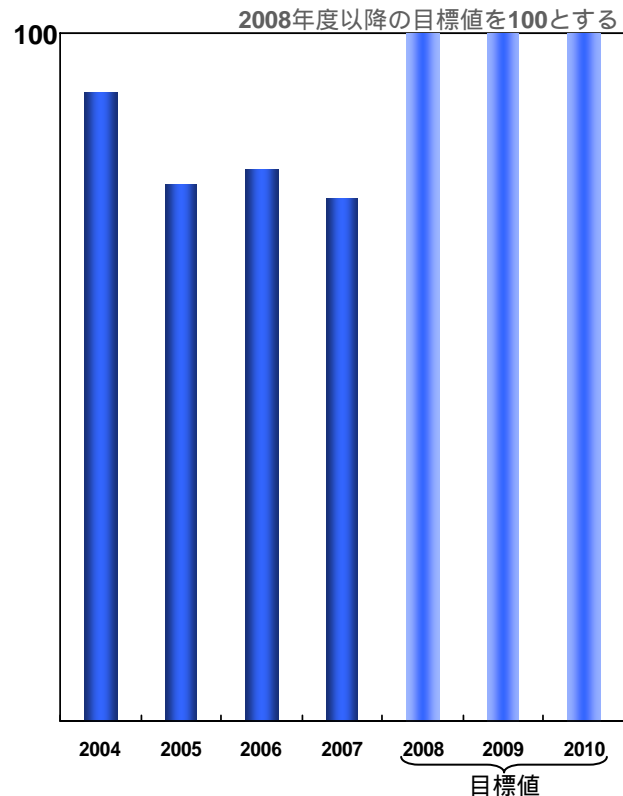


ハイテク業界において、
「**Kiru・Kezuru・Migaku**ならディスコ」として
最も頼られる存在となっている

KKMならディスコ

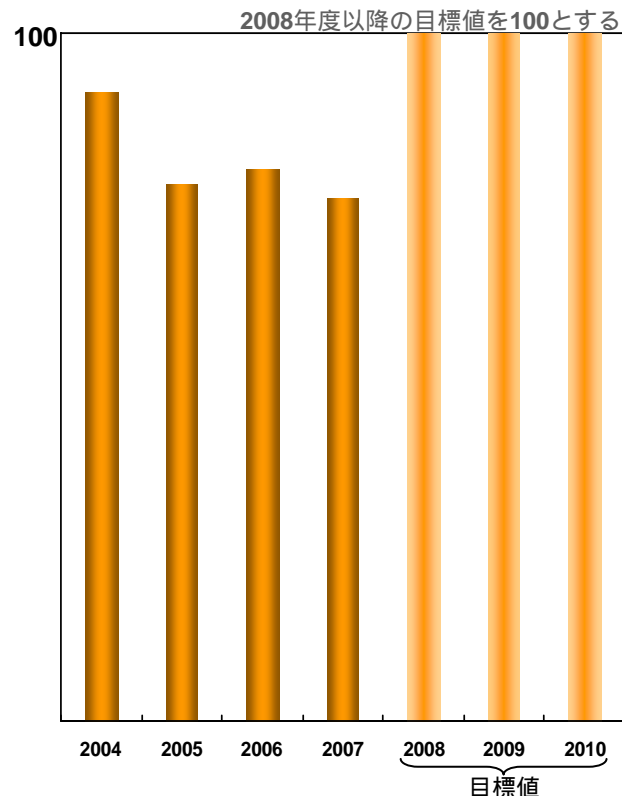
CS調査結果より、選ばれるディスコに進化

総合満足度



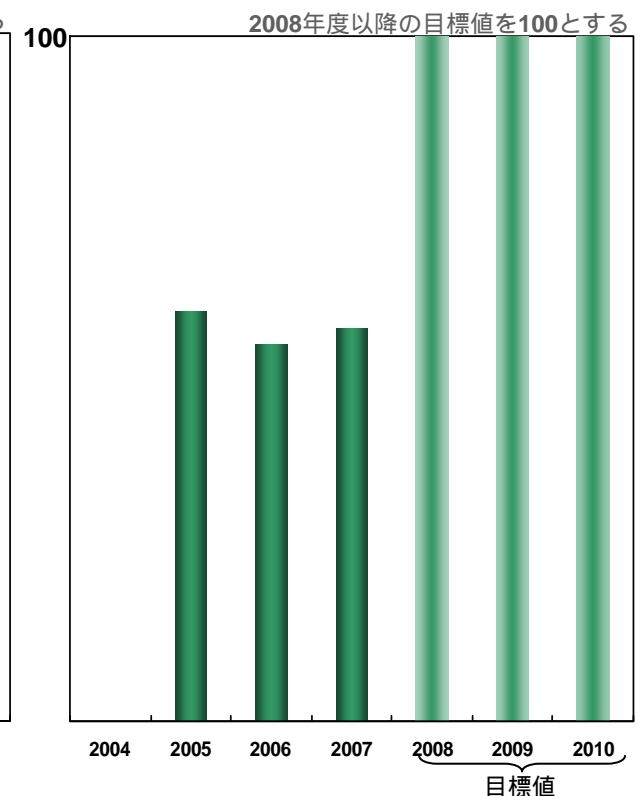
「総合満足度」
評点5及び6の割合

部門間連携



「営業、技術、サービス間の連携」
評点5及び6の割合

KKMのプロ



「KKMのプロ集団」
評点5及び6の割合

1999年よりお客様満足度調査を実施しており、2007年度は9ヶ国語に対応し全世界のお客様にアンケートを依頼。回答率は49.2%。



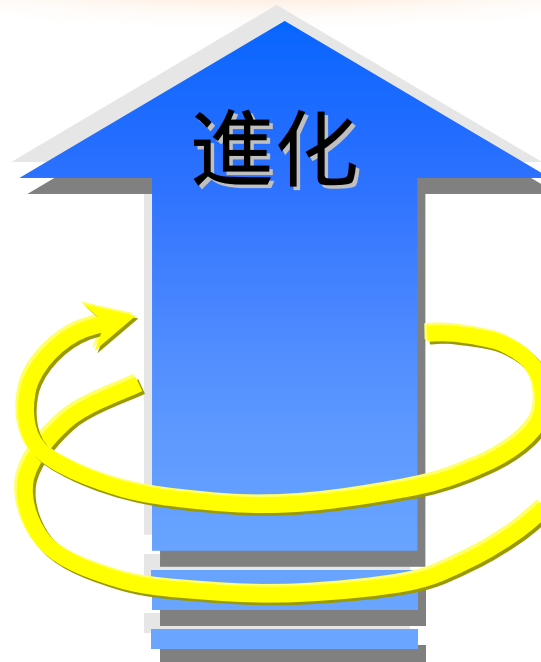
進化する組織づくり～PIM活動～

PIM活動

Performance Innovation Management

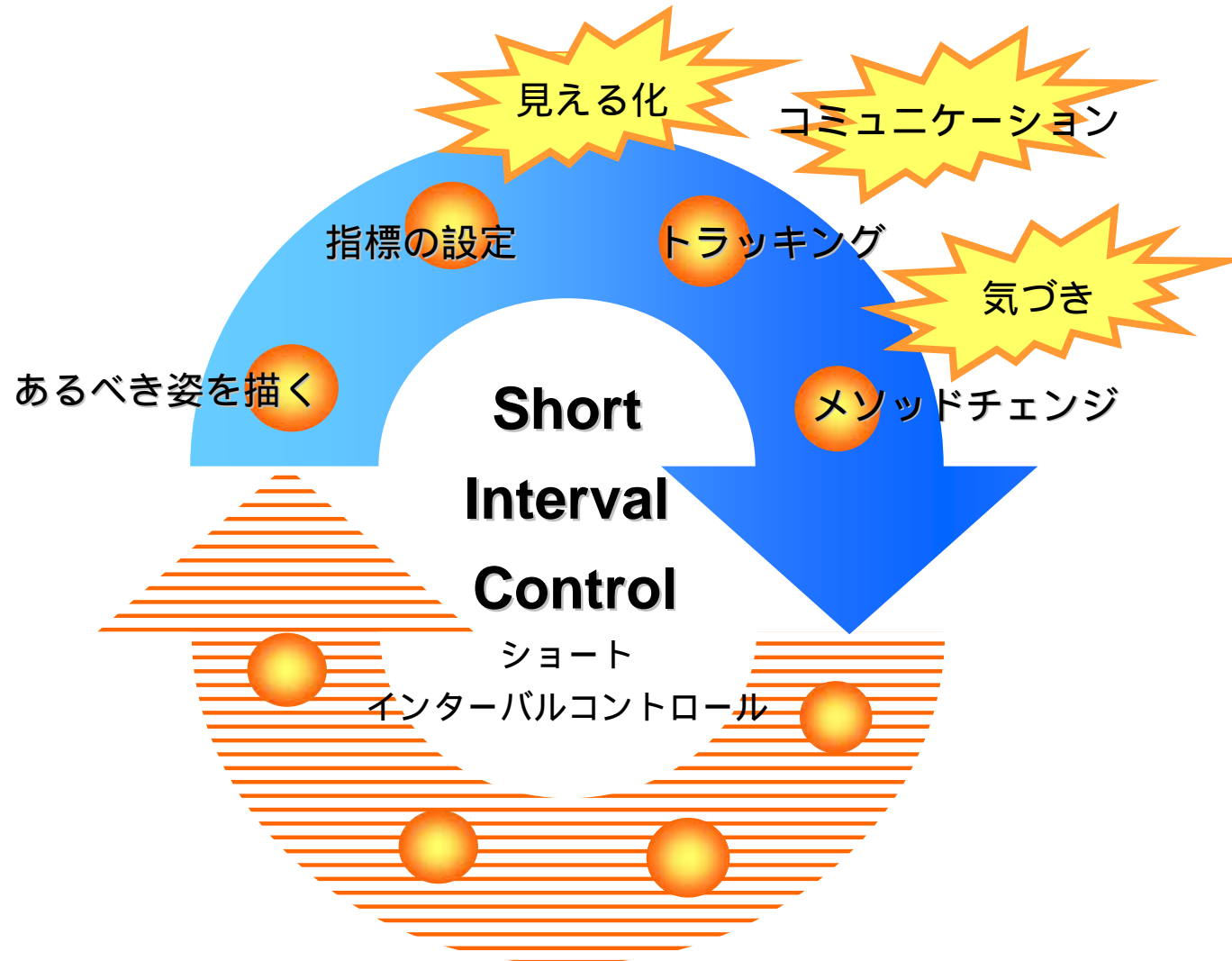
進化のためのツール

あるべき姿



進化し続けるためのプロセス

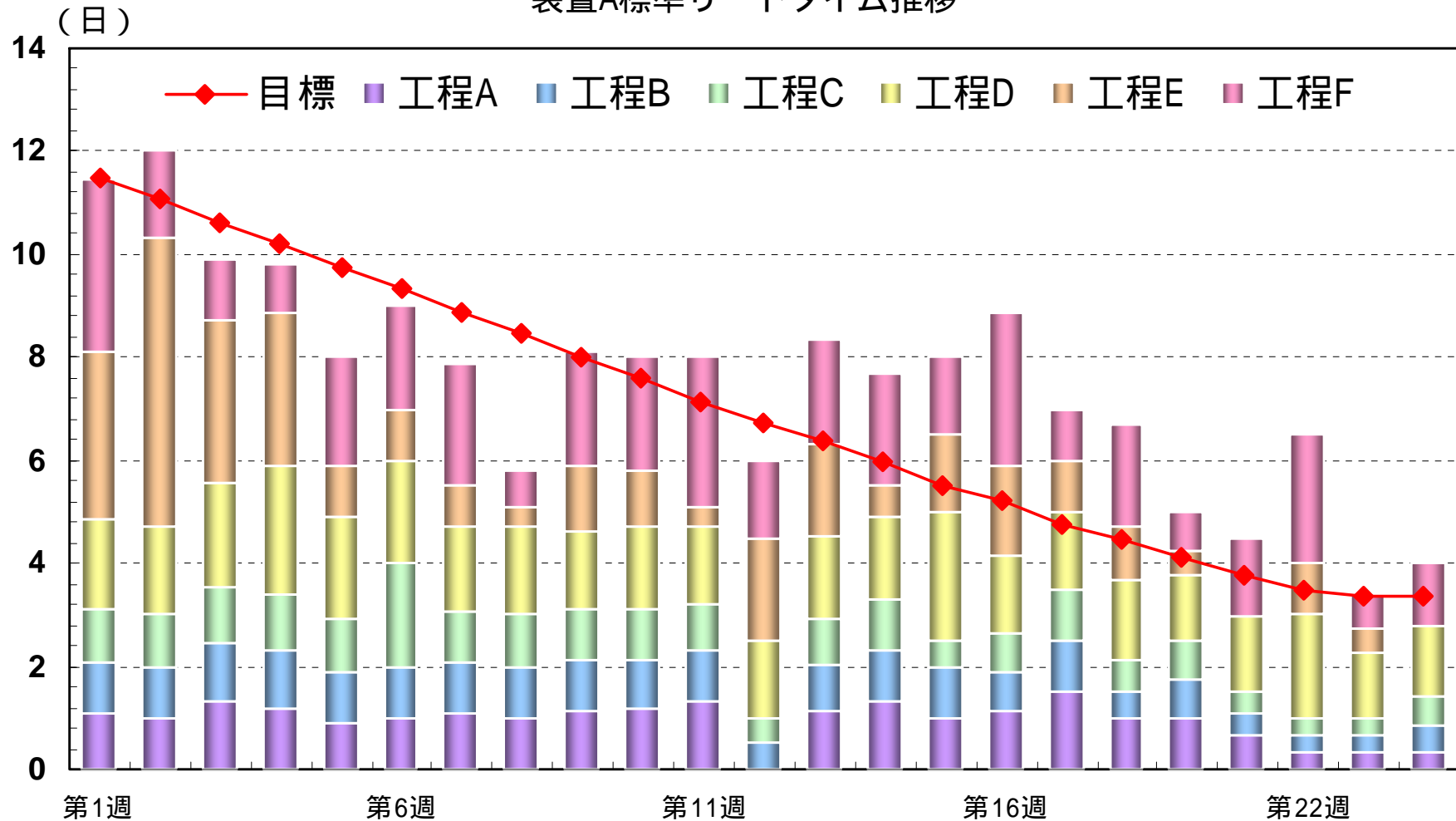
短いサイクルで、気づきを得て、進化を促進



PIM活動による改善例

生産効率の改善

装置A標準リードタイム推移



設備投資進捗状況（1/2）



本社・R&Dセンター Ⅱ期工事

投資総額	80億円
完成予定	2008年11月
目的	<ul style="list-style-type: none">• 研究開発から試作までの効率化• アプリケーション開発スペース拡張• ウェーハの大口径化対応• BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地下1階 地上14階

設備投資進捗状況（2/2）



桑畑工場 新A棟工事
精密加工装置および精密加工ツール生産工場

投資総額	100億円
着工予定	2008年9月
完成予定	2009年12月
目的	<ul style="list-style-type: none"> • 製造現場の集約による効率向上 • 魅力ある労働環境の提供 • 需要拡大への対応 • BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地上8階



DISCO 茅野工場 I期工事
ダイイチコンポーネンツ 茅野工場

投資総額	25億円
着工予定	2008年8月
完成予定	2009年6月
目的	<ul style="list-style-type: none"> • 製造現場の集約による効率向上 • 魅力ある労働環境の提供 • 需要拡大への対応 • BCM対応力の向上
建屋構造	免震構造 地上6階

配当政策および配当額

	中間期	期末	記念配当	年間
2008年3月期(案)	35円	44円	—	79円
2009年3月期(予想)	25円	46円	—	71円
(ご参考) 2007年3月期(実績)	30円	35円	10円	75円

【配当方針】

1. 連結業績に連動した配当（配当性向**20%**）
2. 安定配当として最低**20円**の配当金を維持。ただし**3期連続**で連結純損失の場合を除く。
3. **4年累計連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、通常20%である配当性向を24%とする**
4. 赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*2)を超過した場合は、上記に加え、超過金額の**3分の1**を目処に配当に上乗せする

【注】2008年3月期末時点予定必要資金額 300億円

現預金残高が予定必要資金額を超過しないため配当金の上乗せはなし

本日の説明

1. 2008年3月期決算概要

常務取締役 I R 担当

関家圭三

2. 今期の事業環境と経営方針

代表取締役社長

溝呂木 齊

3. 質疑応答

DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

